

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	青朴资本：严朴 娜嬛资本：任兵 明时投资：孙斌 中金汇融：张克 泽鑫毅德投资：李尚衡 宝润达投资：李礼和 中泰证券：苏城 铭海基金：范凯 中国银河证券：唐海燕 前海融睿投资：徐佳/林向涛 南科大教育基金会：李曾啸 国泰君安：陈剑桥 明富基金：杨帆 中罡矿犇投资：罗旷 德远投资：陆志琴 中信证券：赵宪 君盛投资：何香玲 盈峰资本：李明刚 东财证券：刘琦 微宇基金：刘政科 浩成资产：苏怡文 上海雅策：黄鹤翔 美林证券：高琳雅 Polymer：刘楠 华福证券：赵心怡
时间	2023年6月27日-6月30日
地点	公司会议室
上市公司接待人	副总兼董事会秘书 周红

<p>员姓名</p>	<p>投资者关系主管 侯琦</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>Q: 公司是否有参与人形机器人的供应?</p> <p>A: 公司具备相关产品的技术储备及生产能力, PCB 是电子产品的基础元器件, 只要是电子产品包括机器人都需用到, 而且电子产品对 PCB 板的要求越高, 公司的竞争力就越能体现, 所以该类新产品一旦量产, 公司一定不会缺席。</p> <p>Q: 公司研发是否有与高校合作?</p> <p>A: 公司研发分三个层级, Level1 主要满足客户新品需求, 包括制程优化等方面的创新技术; Level2 主要满足客户未来产品需求, 通过参与客户产品先期研发与设计, 合作发展高阶技术蓝图, 以构建技术优势壁垒; Level3 是通过与高校进行产、学、研合作, 发展自主核心的先进技术能力, 超越客户的需求。目前, 公司已架构产、学、研合作的前瞻技术研发计划开发平台, 并建立技术研发中心, 与两岸三地多所知名大学及研究院包括清华大学、香港城市大学、东南大学、深圳大学、燕山大学等大陆院校及台湾的工研院、台湾大学、台湾新竹清华大学、成功大学等建立了长期合作关系。</p> <p>Q: 公司订单签约形式?</p> <p>A: 公司订单主要以与客户直接签约合作为主。</p> <p>Q: 公司未来三至五年新投产能方向?</p> <p>A: 公司产品通用性比较强, 未来几年公司规划投资的项目包括高阶 HDI 板及 SLP 板、汽车及服务器用板以及在高雄投资建设的软板项目。这些项目的建成, 将进一步提升公司在消费电子及汽车、服务器领域的服务能力,</p>

完善公司的产品布局。未来，公司也将根据下游行业的需求变化情况来决定产能扩充的计划。

Q: 汇率波动对公司产品定价影响?

A: 公司大部分营收以美元结算，美元升值对公司汇兑收益有正向影响。

Q: 公司与同业公司相比主要优势体现在哪些方面? 如何提振市场信心?

A: 公司自成立以来一直服务于国际领先品牌客户，具备良好的公司管理能力、雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力，稳定的产品品质保障能力，能够保障及时向客户量产交货，为客户提供优质领先的产品及服务。

PCB 是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备。近年来，随着新一代信息技术的不断突破，智能化汽车以及 VR 设备等新型电子产品不断发展，以车载 ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR 元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端 PCB 产品需求的快速增长。同时，以 ChatGPT 为代表的人工智能技术的快速发展预计也将带来 AI 服务器及人工智能领域产品的大爆发。Prismark 预测，未来 5 年，5G、人工智能、物联网、工业 4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。根据 Prismark 数据，2022 年至 2027 年，服务器及存储设备领域、汽车领域 PCB 产品分别以 7.6%、5.7% 的复合增长率成为增长最快的细分产品应用领域之

一。电子行业未来蓬勃发展的新趋势，为公司提供了优秀的发展赛道，公司紧跟电子产品发展潮流与趋势，提前进行了高信赖性车规级、微小 LED、毫米波级、AI 高速运算及 ARVR、智能穿戴式相关产品研发技术的储备，已经具备了关键产品产业化的技术实力；同时，在新一代信息通信产业领域中，公司不断加大在 5G、6G、云端、大数据、物联网、人工智能、新能源、车载电子等产品研发方向上的深入布局，围绕新材料、新产品、新制程、新设备和新技术五大主轴，全力聚焦关键共性技术与产品前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向。

以公司董事长为核心的管理团队，非常重视稳健的企业经营管理，公司以市场分析作为根据，立定经营愿景、经营目标、经营策略，扎实地一步一脚印扩展产业版图。公司具有良好的财务指标与现金流水平，健康的财务状况和良好的抗风险能力，能为公司不断扩张与可持续发展保驾护航。未来，公司将继续深耕主营业务，充分发挥公司各方面优势，努力提升公司内在价值，在做好公司基本面的同时将加强市场交流，让投资者更加充分地了解公司可持续发展能力与长期投资价值。

Q: 公司账上现金流比较充裕，目前时点进行定增是出于什么考量？

A: 公司现金流等方面十分健康，但考虑到未来业务规模的增长及经济环境的不确定性，公司希望增强自身资本实力以把握市场机会，实现更好的发展。

Q: 公司在台湾扩建产能的考量？

A: 公司坚持“扎根大陆，布局两岸，服务全球”发展策

略，在台湾扩建产能一方面可以进一步优化地域布局，同时，通过在台湾扩产，能不断吸引更多当地优秀的专业人才，从而持续提升公司的技术及管理能力。公司一直定位高端 PCB 产品，竞争格局相对清晰，作为一家服务全球客户的国际化公司，目前公司已在印度、台湾高雄建厂，同时也会关注其他区域扩产的机会，持续完善区域布局，提升公司服务不同领域客户的能力。

Q: 公司汽车电子领域客户开发情况？

A: 在汽车电子领域，公司主要专注于电池板、域控制器板、摄像模组、雷达等传感器用板，目前已有包括电池软板、自驾域控制器、雷达模组、摄像模组等在内的多款车载产品通过认证，相关产品也已陆续批量供货。公司汽车电子领域合作的客户主要为电池厂及 Tier1 厂商。

Q: 公司留住高端人才方式有哪些？

A: 公司一向注重人才培育，积极营造能让员工发挥所长、不断成长的学习成长环境，同时，公司有效整合各类训练资源，不断提升组织学习氛围，有系统的培养公司发展所需的各类人才。此外，公司配套了人才激励相关政策，包括股权激励、员工持股平台等措施。

Q: 公司今年在大客户中的新品和份额是否仍有所增加？

A: 公司持续与全球领先品牌客户合作，凭借及时快速的订单响应能力、完善的品质保障能力，与客户建立了长期稳定的供应关系，实现稳定成长。未来公司也将继续通过进行技术创新与开发，不断开拓新产品，新领域，提升公司市场份额。

Q: 公司怎么看待 AI 未来发展机遇？

	<p>A: Open AI 的出现将带来底层算力需求的快速释放, AI 服务器领域有望迎来新的发展机遇, 同时, 在 AI 技术催化下, 将调动更多终端产品的创新升级发展。PCB 作为整个电子产业链的基础元器件, 具备广阔的发展空间。</p> <p>接待过程中, 公司接待人员与投资者进行了交流与沟通, 并严格按照有关制度规定, 没有未公开重大信息泄露等情况, 同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 6 月 30 日